



辛耘 (3583)

2022年8月30日

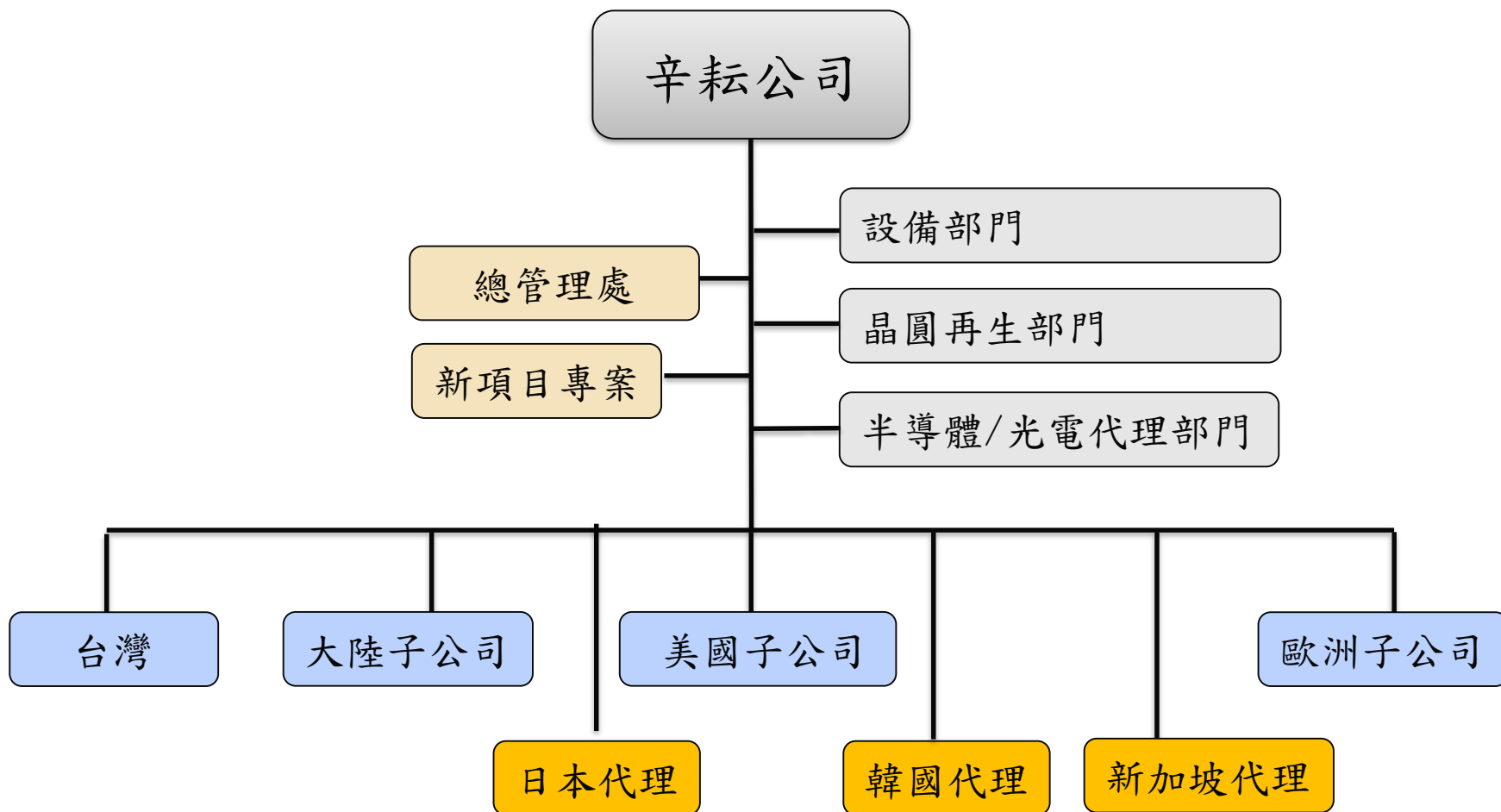
免責聲明

- 本簡報可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時又受限於已知或未知的風險與不確定性的影響。因此實際結果將可能不同於表述內容。
- 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

基本資料

成立時間	1979/10/17
董事長	謝宏亮
執行長	許明棋
資本額	8.11億元
營收(2021)	46.84億元(集團合併)
員工人數	740人(集團合併)
據點	台北、湖口、新竹、台南、高雄、大陸(上海等17個城市)、香港、美國、歐洲(奧地利)、日本、新加坡、韓國
主要業務	自製設備、晶圓再生、設備代理

辛耘公司組織架構



營運概況

主要產品

公司治理

未來展望

單位：百萬	2017	2018	2019	2020	2021	2022/H1
營業收入	<u>3,539</u>	<u>3,988</u>	<u>3,949</u>	<u>3,580</u>	<u>4,684</u>	<u>2,637</u>
營業毛利	<u>1,251</u>	<u>1,448</u>	<u>1,384</u>	<u>1,456</u>	<u>1,667</u>	<u>972</u>
營業費用	829	935	997	991	1,112	670
營業淨利	423	514	387	465	555	302
營業外收入及支出	(8)	26	16	(76)	(31)	29
稅前淨利	415	540	403	389	524	331
本期淨利	328	418	323	305	420	273
EPS(元)	<u>4.05</u>	<u>5.16</u>	<u>4.02</u>	<u>3.80</u>	<u>5.23</u>	<u>3.40</u>
毛利率	35%	36%	35%	41%	36%	37%
營業淨利率	12%	13%	10%	13%	12%	11%
稅前淨利率	12%	14%	10%	11%	11%	13%

營運概況

2022/H1 營運概況



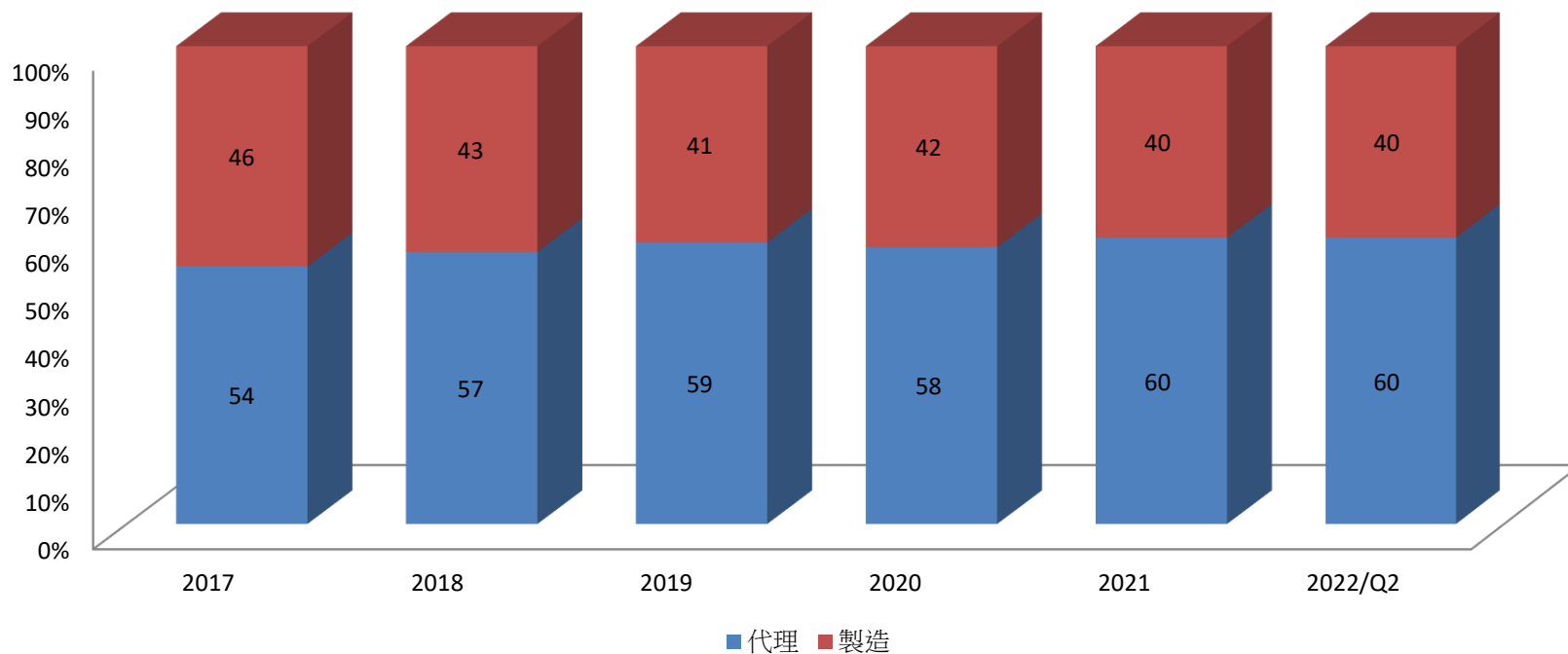
單位：百萬	1Q21	2Q21	1Q22	2Q22	1H21	1H22	1H22 VS 1H21
營業收入	956	1,002	1,254	1,383	1,958	2,637	35%
營業毛利	266	397	461	511	663	972	47%
營業費用	253	219	332	338	472	670	42%
營業淨利	13	178	129	173	191	302	58%
營業外收入及支出	24	(8)	26	3	16	29	79%
稅前淨利	37	170	155	176	207	331	60%
本期淨利	20	147	121	152	167	273	64%
EPS(元)	0.25	1.84	1.51	1.89	2.09	3.40	63%
毛利率	27.80%	39.60%	36.80%	36.90%	33.90%	36.90%	+3.0ppt
營業淨利率	1.40%	17.80%	10.30%	12.50%	9.80%	11.40%	+1.6ppt
稅前淨利率	3.90%	17.00%	12.40%	12.70%	10.60%	12.50%	+1.9ppt

營運概況

產品組合

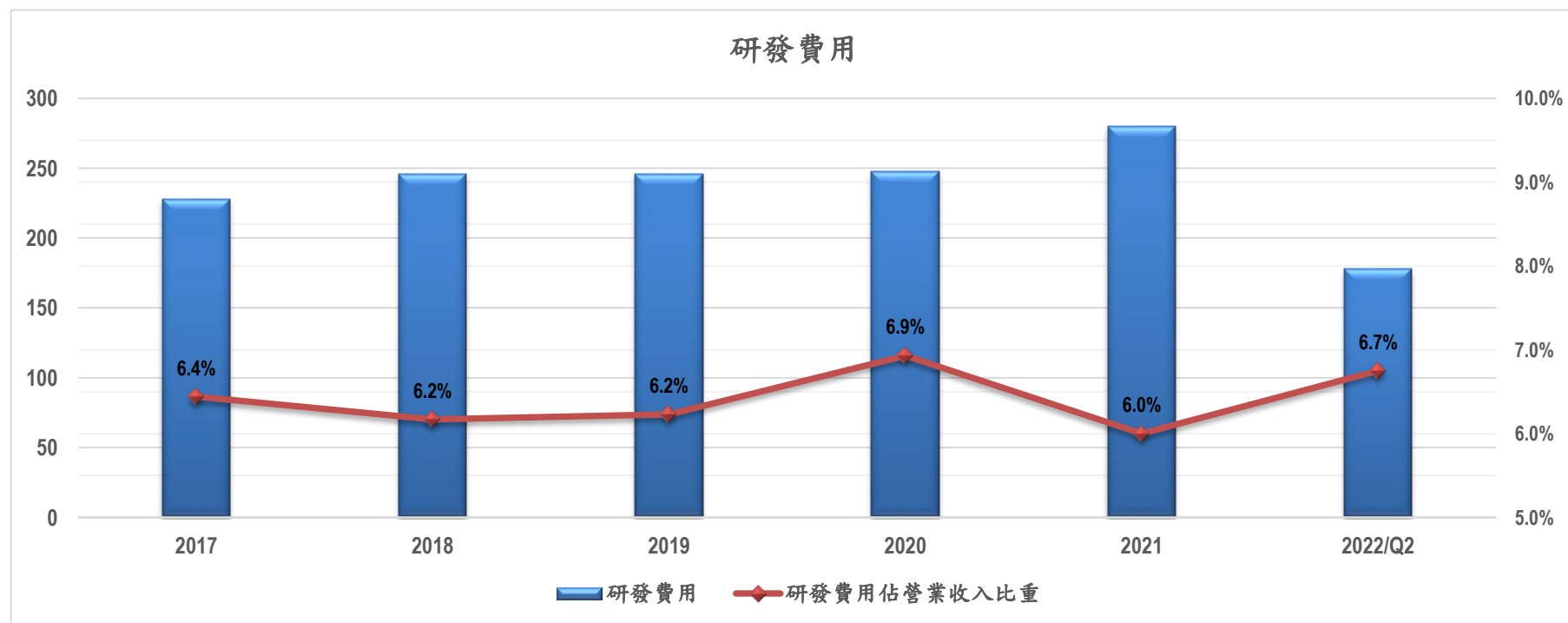


單位：%	2017	2018	2019	2020	2021	2022/H1	毛利率
代理	54	57	59	58	60	60	低於平均
製造	46	43	41	42	40	40	高於平均

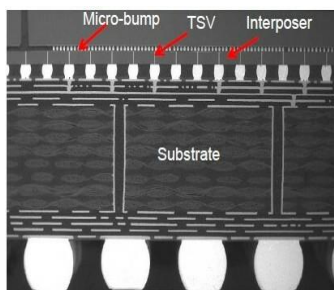
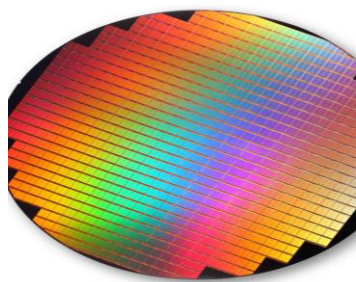


產品 (單位：百萬)	1H21		2H21		1H22		YoY
代理	1,293	66%	1,540	56%	1,594	60%	23%
製造	665	34%	1,186	44%	1,043	40%	57%
合計	1,959	100%	2,725	100%	2,637	100%	35%

單位：百萬	2017	2018	2019	2020	2021	2022/H1
研發費用	228	246	246	248	280	178
研發費用 佔營業收入比重	6.4%	6.2%	6.2%	6.9%	6.0%	6.7%



- 我們服務的產業：
 - 半導體 (前段/先進封裝)
 - 化合物半導體
 - LED / Mini LED / Micro LED
 - 平面顯示器 (TFT-LCD, AMOLED, Touch Panel)
 - 太陽能/電池
 - 生物科技/分析儀器



- 半導體
- 化合物半導體
- LED
- 平面顯示器
- 太陽能/電池
- 生物科技/分析儀器

設備生產

- 濕式製程設備
- 暫時性貼合及剝離設備
- 半導體/化合物/LED

代理事業

晶圓再生

- 12" Si (矽) Wafer
- 6" SiC (碳化矽)

● 辛耘公司



SCIENTECH

■ 12"Si晶圓再生

- ◆ 產能: 12 → 14 → 16萬/月
- ◆ 銅及非銅製程分離

■ SiC長晶後全製程及晶圓再生

- ◆ 產能: 800 / 月

Advanced clean technology

- 65nm/ 45nm Particle
- Low trace metal (<1E10)

Cleaning

Complete particle inspection
(SP1-DLS & SP2)

Etching

Full Process
Optimization

Polishing

Grinding

Complete polishing process

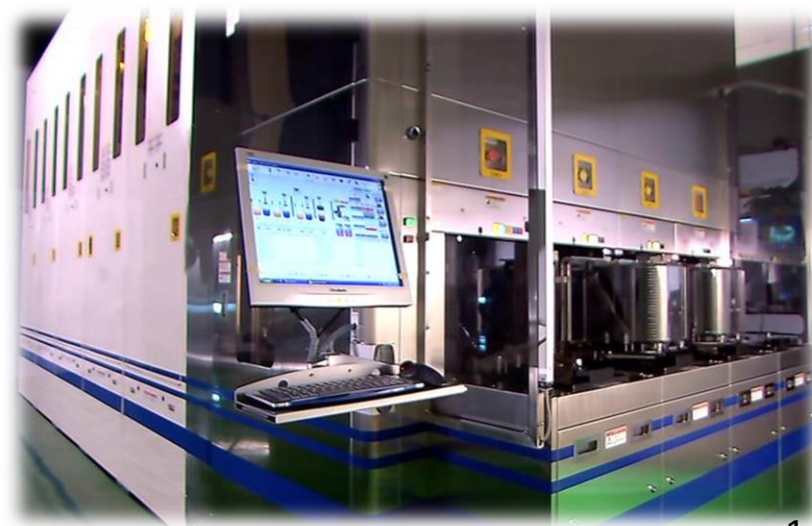
Super flatness
(GBIR<0.5μm)

- 辛耘公司



SCIENTECH

- 批次式及單晶圓濕式製程設備
- 應用：
 - ◆ 半導體先進封裝製程
 - ◆ 半導體前段製程
 - ◆ 化合物半導體製程
 - ◆ 微機電製程
 - ◆ LED/Mini-LED/Micro-LED製程



- 辛耘公司



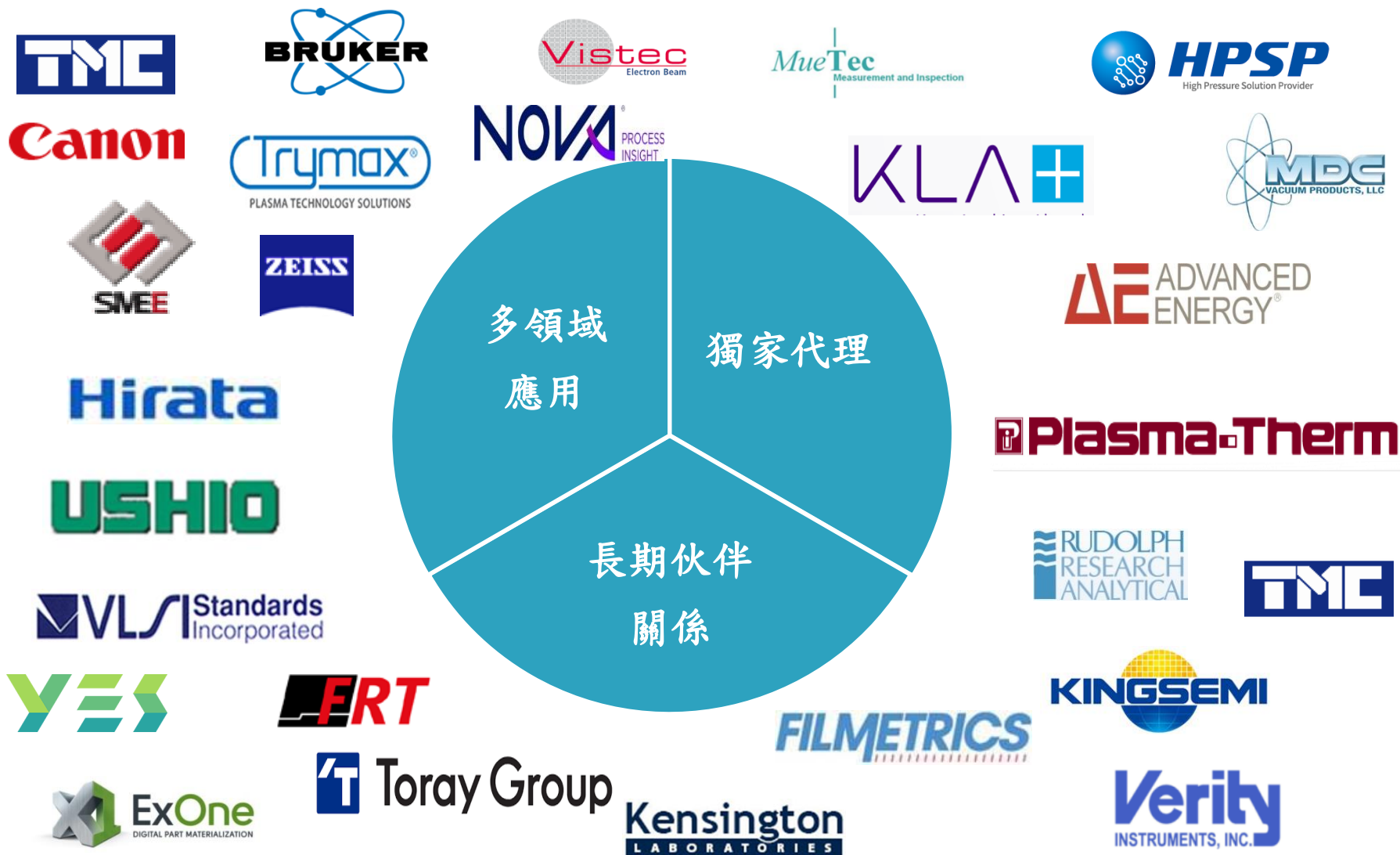
SCIENTECH

- 暫時性貼合及剝離設備(TBDB)
- 應用: IGBT功率器件, 半導體先進封裝
 - ◆ 暫時性貼合設備
 - ◆ 暫時性剝離設備
 - ◆ 解離層塗佈設備
 - ◆ 承載盤清洗設備



主要產品

設備代理



公司治理

ISO



Initial Certification

2014/5/27

Valid Date :

2020/5/28 ~ 2023/5/27

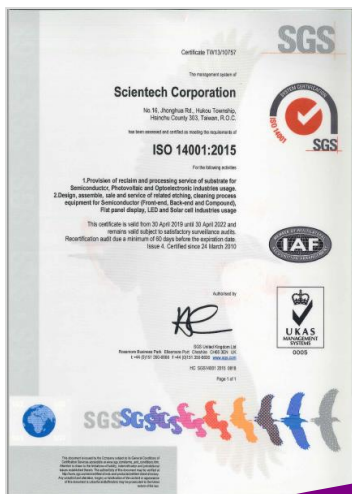


Issue 4. Certified since

2010/3/24

Valid Date :

2019/4/30 ~ 2022/4/30



Issue 3. Certified since

2019/4/30

Valid Date :

2019/4/30 ~ 2022/4/30



Issue 1. Certified since

2019/11/20

Valid Date :

2019/11/20 ~ 2022/11/19



Issue 1. Certified since

2021/09/29

Valid Date :

2021/09/29 ~ 2024/09/28



ISO14001

ISO45001

ISO27001

資訊安全

ISO22301

營運持續

ISO9001



Taiwan Intellectual Property Management System

台灣智慧財產管理規範 (TIPS) 驗證登錄證書

Certificate of Taiwan Intellectual Property Management System

貴公司所建置之智慧財產管理制度，通過台灣智慧財產管理規範 (TIPS) 推行體系之驗證，特此證明。相關登錄事項如下：

- 一、公司名稱：辛耘企業股份有限公司
- 二、受評部門：全公司
- 三、受評地址：新竹縣新豐鄉中華路 18 號
- 四、證書編號：TIPS-2016-驗證-008
- 五、有效期限：2021/12/31
- 六、管理標的：☒專利 ☒商標 ☒著作權 ☒營業秘密 ☐積體電路佈局
- 排除適用：無
- 七、驗證類別：☒AA 級 ☐A 級 (2016 年版)

經濟部工業局
局長 呂正華

Certificate of Compliance

This is to certify that the Intellectual Property Management System of the following organization has been verified and fulfilled the requirements of TIPS.

- 1. Company Name : Sciencetech Corporation
- 2. Registered Department : All Company
- 3. Registered Address : No. 18, Zhonghua Rd., Hukou Township, Hsinchu County 30352, Taiwan (R.O.C.)
- 4. Number of Registration : TIPS-2016-cert-008
- 5. Date of Expiration : December 31, 2021
- 6. Items : ☒ Patent ☒ Trademark ☒ Copyright ☒ Trade Secret ☐ Integrated Circuit Layout
- Exclusion : None
- 7. Certification Level : ☒ AA ☐ A (2016)

Director General
Industrial Development Bureau, MOEA

Richard Lee

簡報結束
謝謝！

Q&A